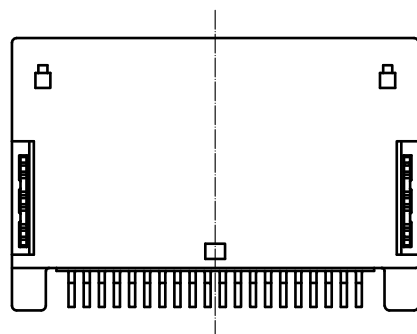
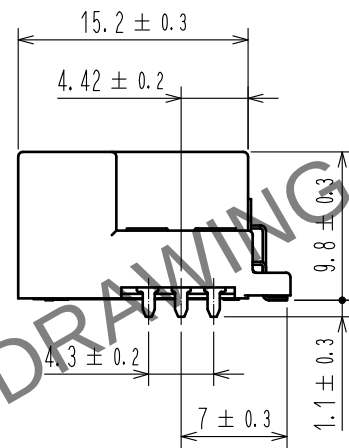
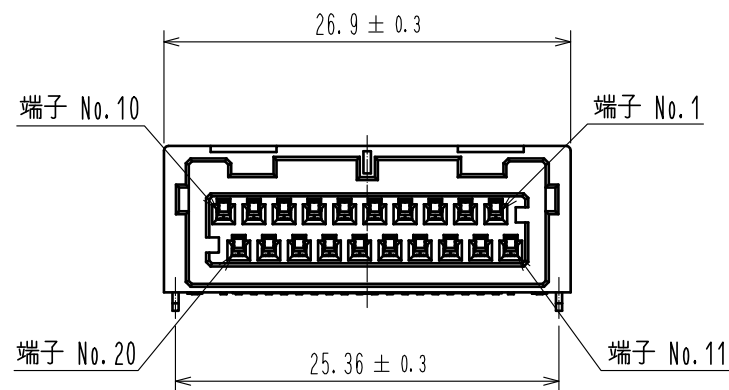
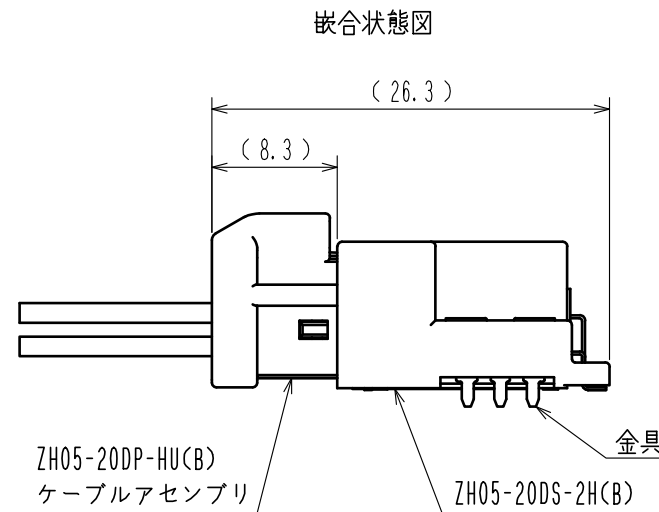
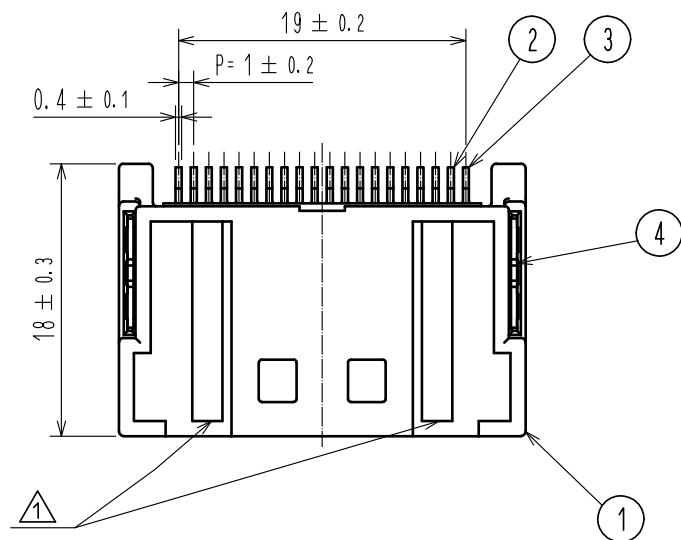
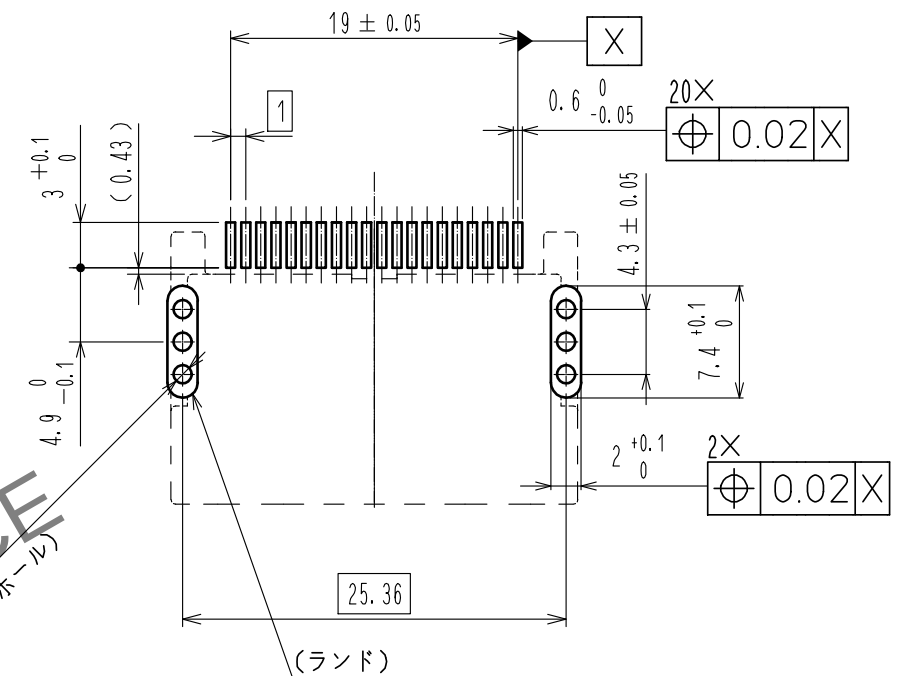


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

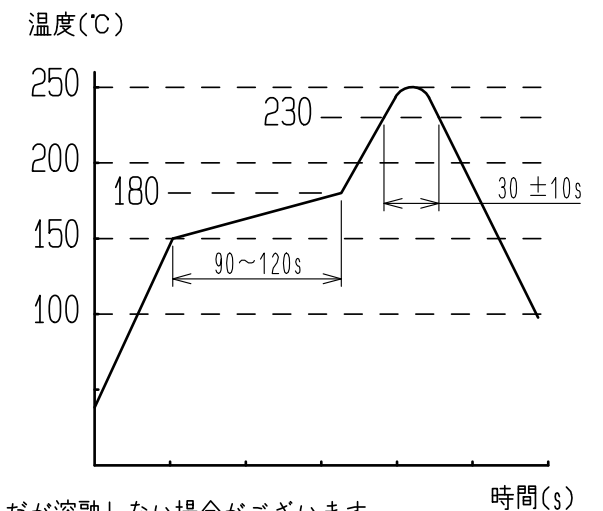
ELV, RoHS 適合品



推奨基板寸法図 (FREE)
(基板厚: $t=1.6$ mm, メタルマスク厚: $t=0.1$ mm)



- 注1. 推奨温度プロファイル (右表参照)
使用リフロー加熱方式 : 遠赤外線、エア大気中または窒素中
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250°C
 230°C 以上 : $20 \sim 40$ s
プリヒート温度 : $150 \sim 180^{\circ}\text{C}$
 $90 \sim 120$ s
2. 手ハンダ/ハンダこて温度 : $280 \sim 300^{\circ}\text{C}$, 2S 以内
3. 端子平坦度は 0.1 mm 以下とする。
4. 推奨基板厚は $T=1.6$ mm とする。
5. 推奨はんだ厚は 0.10 mm とする。
6. 実装時の状況により、実装部の温度上昇が抑えられはんだが溶融しない場合がございます。その際、はんだを溶融させるためにリフロー温度を上昇させると、ハウジングに 250°C 以上の過剰な熱が加わりプリスターが発生する恐れがございます。実装時はハウジング表面が 250°C を超えないことをご確認ください。



3	銅合金	表面: すずめっき $1\mu\text{m min}$	6	ポリエステル	
2	銅合金	下地: ニッケルめっき $1\mu\text{m min}$	5	ポリスチレン	
1	PA	表面: すずめっき $1\mu\text{m min}$	4	黄銅	表面: すずめっき $1\mu\text{m min}$
		下地: ニッケルめっき $1\mu\text{m min}$			下地: ニッケルめっき $1\mu\text{m min}$
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00020522	DESIGNED YANG CHUAN XING
		APPROVED : MH. SHOUJI	20221207	DRAWING NO. ADC-389971-80-00	
		CHECKED : MH. SHOUJI	20221207	PART NO. ZH05-20DS-2H(B)	
		DESIGNED : YANG CHUAN XING	20221207	CODE NO. CL0756-2105-0-80	
		DRAWN : YANG CHUAN XING	20221207		
				DATE 20240325	

HRS	DRAWING NO.	ADC-389971-80-00	
	PART NO.	ZH05-20DS-2H(B)	
	CODE NO.	CL0756-2105-0-80	1 2/2